

講演募集

「第28回学生会員卒業研究発表講演会」

－ 今後の精密工学を担う萌芽的研究 －

第28回「学生会員卒業研究発表講演会」を下記のとおり、オンラインにて開催いたします。学生会員卒業研究発表講演会の趣旨は若手会員の学会への参加意識を高めると同時に、学生に経験を積ませ育成することにあります。なお本会の趣旨により、発表する卒業研究の内容は、精密工学に関係したものとし、発表する学生は学部および工業高専の最終年次に所属し、精密工学会の学生会員（学生会員 web 級含む）であることを条件とします。また、卒業研究発表論文集に掲載された論文は工作機械技術振興財団の工作機械技術振興賞（奨励賞）の審査対象となる可能性があり、毎年1～2名が受賞しています。大会の正式行事として実施いたしますので、学生会員（学生会員 web 級含む）の皆さまの参加を期待しております。

1. **開催日** 2021年3月16日（火）9時～22日（月）24時（発表者による公開質問回答期間含む）

2. **開催方法** オンデマンド方式によるオンライン開催

3. **発表申込期間** 2020年12月25日（金）9時～2021年1月20日（水）正午まで（締切厳守）

4. **講演論文原稿締切** 2021年2月5日（金）正午（締切厳守）

5. **発表動画提出締切** 2021年2月28日（日）正午（締切厳守）

6. **講演論文集公開予定** 2021年3月9日（火）（「学生会員卒業研究発表講演会講演論文集」学会ウェブページ公開日）

※ 学生会員卒業研究発表講演会講演論文集は、第22回講演会（2015年3月17日開催）より学会ウェブページにて公開しております。

7. 本講演会について

1) 本講演会は、あらかじめ提出された発表動画を開催期間中にウェブで閲覧いただくオンデマンド方式で開催します。公開での質疑応答は、動画再生時のコメント欄を使用いたします。なお、発表動画は10分間以内の音声入り発表動画を提出締切日までに指定の方法で提出していただきます。

2) 詳細な開催日程は下記のとおりです。

2021年3月16日（火）9時～22日（月）24時（講演発表者による公開質問回答期間含む）

3月16日（火）9時～18日（木）24時 公開質問期間（この間に講演発表者からの随時回答も可）

3月22日（月）24時 講演発表者からの公開質問への回答締切

なお会期後、公開質疑確認期間として3月29日（月）正午まで、質疑情報と発表動画の閲覧を可能にいたします。

公開質疑確認期間 3月23日（火）～29日（月）正午

発表動画公開全期間 3月16日（火）～29日（月）正午

3) オンライン開催のため、従来講演会と異なる準備が必要となります。また、日程の都合上、締切延長措置は予定しておりませんので、締切厳守にご協力いただけますようお願いいたします。

8. 発表申込について

1) 発表申込は締切日までに 発表申込受付サイト から行ってください。申込締切後、直ちに作業を進めますので、遅れたものは受付できません。

問合せ先：公益社団法人 精密工学会 大会係 E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp

2) 発表者は学生会員（学生会員 web 級含む）に限ります。学会へ未入会の場合は、発表申込と同時にまたはそれ以前に入会手続きをしてください。なお、発表者を筆頭に申し込んでいただきますが、発表原稿での著者の順番は、これに従う必要はありません。また、指導者と連名での申込みを原則とします。

- 3) 発表申込金 ¥5,000 (税込)
- 4) 講演論文原稿は「学生会員卒業研究発表講演会 PDF 原稿の書き方・見本」を参照のうえ作成して、締切日までに指定のウェブページから提出してください。
- 5) 発表動画は、1 講演 10 分間以内の音声入りファイルを指定の方法で提出してください。ファイルは、720p(1280x720)から 1080p(1920x1080)程度の解像度で、1 講演 500MB 以下の mp4 ファイルを作成してください。提出締切日を過ぎた発表動画は受理できませんので、期日厳守をお願いいたします。また、提出方法の詳細、ならびに発表動画の参考例を準備ができ次第、学会ホームページで公開します。
- 6) 発表申込期間を過ぎての発表の取消しは参加者に多大な迷惑をかけ、大会実行委員会ならびに本講演会担当委員会が準備を進めるうえでも支障をきたしますので、発表取消は行わないよう注意願います。
- 7) 卒業研究発表講演会講演論文および発表に用いる言語は日本語または英語とします。
- 8) 学生会員卒業研究発表講演会講演論文集に収録された論文の著作権および要旨集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。本会の著作権は複製権、翻案権、翻訳権を含みます。
- 9) 本講演会での発表にあたり、通常の集会形式よりも録画や撮影の危険性が増すことをご理解いただき、発表資料の取り扱いに注意して発表していただくこと、種々のパスワード等の講演発表者限定情報を厳重に管理いただき、第三者に伝えないことに同意いただきます。大会実行委員会ならびに本講演会担当委員会は、参加者へ発表画面の録画や撮影をしないよう最大限の要請をいたします。

9. 発表申込の入力要領

- 1) 同一題目の第 1 報～第 n 報には必ず副題を入れてください。
- 2) 要旨は発表動画掲載順決定の際参考とするものです。また本講演会講演論文集掲載の要旨集に収録します。内容（要点）を簡潔に記入して下さい。
- 3) 今回の本講演会におけるプログラム分類・コード・キーワードの入力については、別紙一覧表から発表内容にふさわしいキーワードを選択し、その分類・コードを所定欄に入力してください。

10. 発表動画の掲載について

発表動画の掲載順は、本講演会担当委員会であるアフィリエイト委員会が責任を持って決定いたします。

11. 評価について

評価は、講演論文・発表・質疑応答に対して採点を行う方式で行います。また本講演会では特に、その趣旨に基づき、「発表者本人の研究への貢献度」を重要視します。そのため、研究内容・成果のうち、発表者本人が寄与した範囲はどの部分が明確になるように発表してください。

12. 表彰について

優秀な発表者に対しては「卒業研究発表講演会優秀講演賞」を贈ります。なお受賞者は学会ウェブページにて公表いたします。

締切日は厳守してください

発表申込期間を過ぎての題目、発表者の変更は原則として認めません

<分類表>

- A : 設計・生産システム
 B : 精密加工
 C : メカトロニクス・精密機器
 D : 精密計測
 E : 人・環境工学
 F : 材料・表面プロセス
 G : バイオエンジニアリング
 H : ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
A	01	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	意匠設計 (スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニファクチャリング
A	04	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術 (画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS (Product-Service Systems, 製品サービスシステム), 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	09	サステナブル生産, 循環型生産, スマートデバイス, 機械学習
A	99	設計・生産システム一般
B	01	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	超砥粒ホイール, ツルレーン・ドレッシング, 研削盤, 超砥粒ホイール応用加工技術
B	08	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	09	ナノ精度, 鏡面研削, ELID研削
B	10	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	11	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	磁場・電場援用研磨 (加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術 (スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工 (含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	レーザ加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション
B	17	付加製造, 3Dプリンティング, M I D

<分類表>

- A : 設計・生産システム
 B : 精密加工
 C : メカトロニクス・精密機器
 D : 精密計測
 E : 人・環境工学
 F : 材料・表面プロセス
 G : バイオエンジニアリング
 H : ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	キーワード
B	18	次世代研磨技術, 砥粒開発, 数値解析, 副資材開発, 砥粒再生技術
B	99	精密加工一般
C	01	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ
C	03	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	05	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化, 微小部品加工
C	99	メカトロニクス・精密機器一般
D	01	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	知的計測
D	03	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リソグラフィ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
D	99	精密計測一般
E	01	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
E	99	人・環境工学一般
F	01	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	02	ドライエッチング, 材料合成, 物質変換, 材料改質, ガス改質, 新規プラズマ応用技術, プラズマ計測, プラズマシミュレーション
F	99	材料・表面プロセス一般
G	01	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニクス, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
G	99	バイオエンジニアリング一般
H	01	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニクス, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニクス, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニピュレーションシステム, アセンブリシステム, デザインシステム
H	03	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント
H	04	ナノアプリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
H	99	ナノテクノロジー・新領域一般